

2QD0108T17-CN 驱动器



该图片仅供参考，请以实物为准。

特征

- 100% 国产器件
- 双通道 IGBT 驱动器
- 功率器件最高电压 1700V
- 单通道驱动功率 1W，峰值电流 $\pm 8A$
- 直接 / 半桥模式选择
- 集成原边 / 副边电源欠压保护
- 集成有源钳位
- 集成 VCE 短路保护
- 绝缘电压高达 6000V

RoHS
COMPLIANT

主要参数

V_{CC}	15V
V_G	+15V, -10V
P, MAX	1W
I_G , MAX	$\pm 8A$
f_S , MAX	50kHz
T_A	-40°C ~85°C
绝缘耐压	6000Vac

描述

2QD0108T17-CN 是一款基于青铜剑自主开发的 ASIC 芯片设计而成的全国产化的双通道中功率紧凑型驱动核，针对高可靠性领域设计而成。

2QD0108T17-CN 驱动器适用于 1700V 及以下的大部分 IGBT 模块搭建的多种拓扑，和客户端外围电路配合驱动 IGBT。

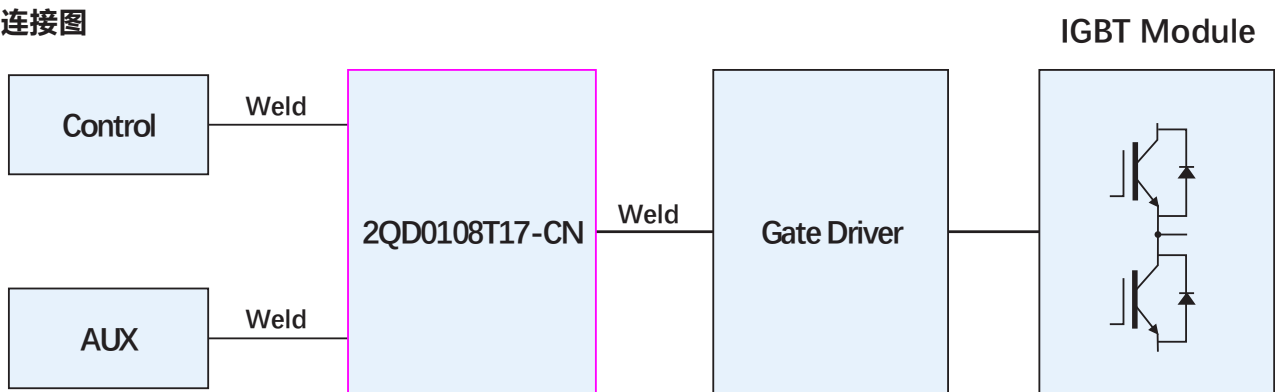
典型应用

- 光伏逆变器
- 风电变流器
- 储能变流器

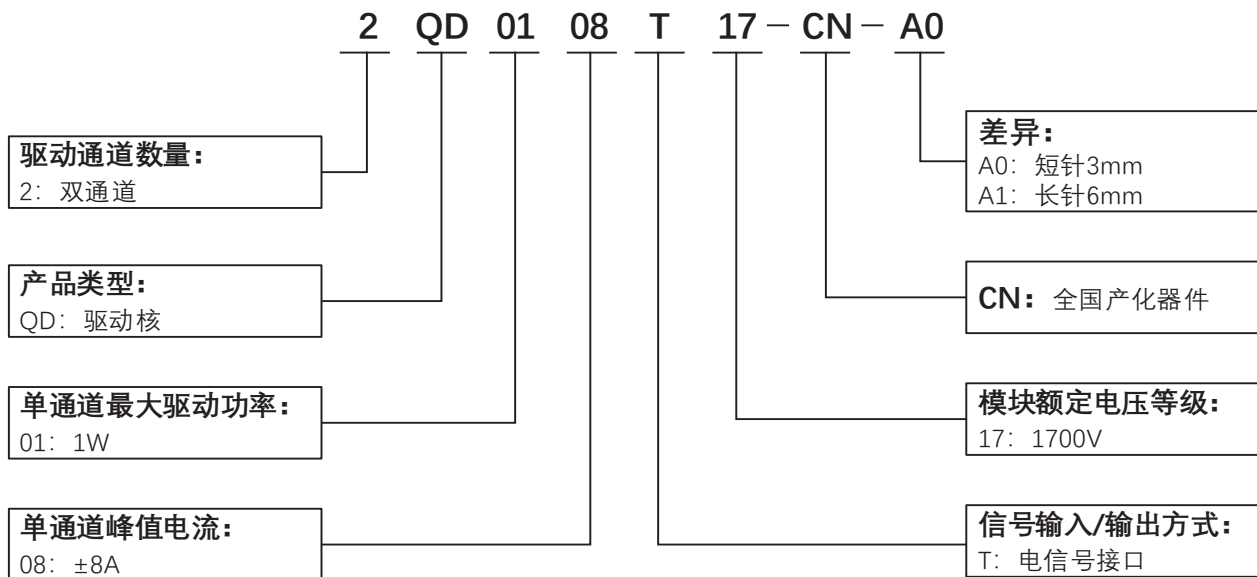
机械尺寸

机械尺寸图：参见第 13 页

连接图

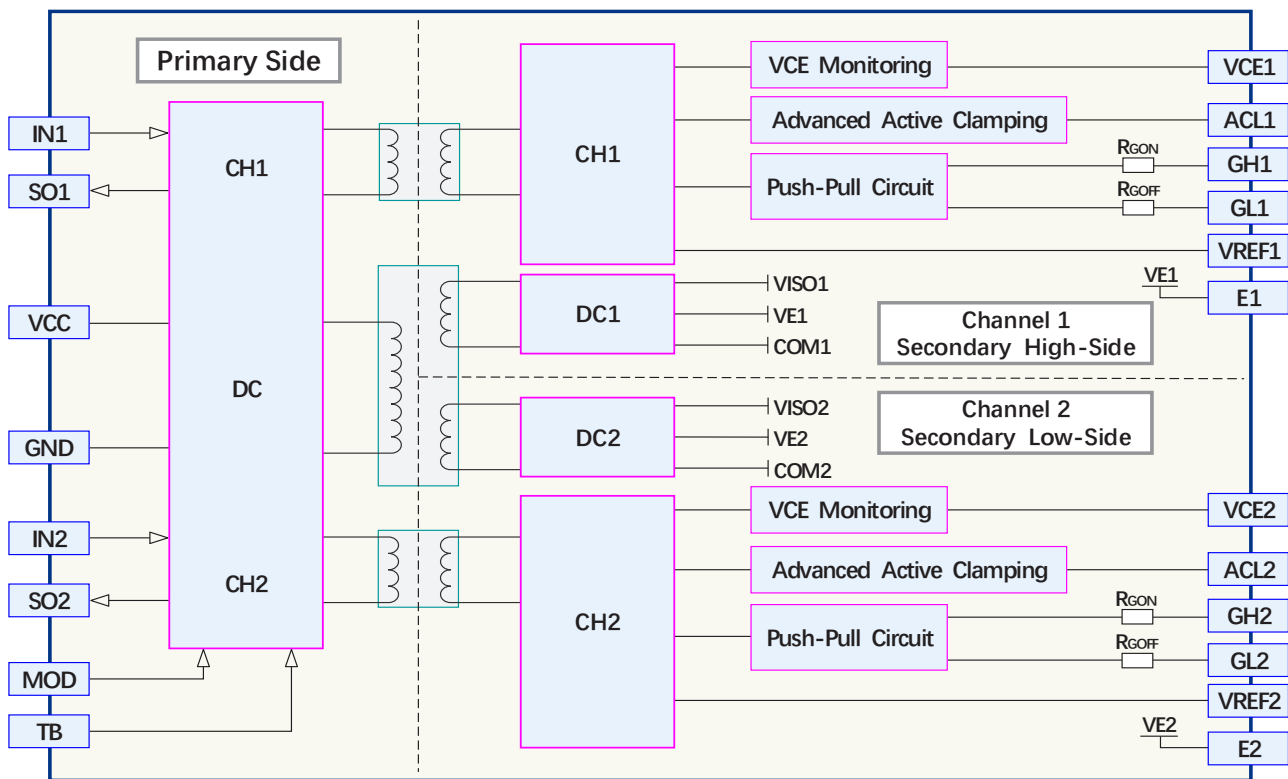


型号定义

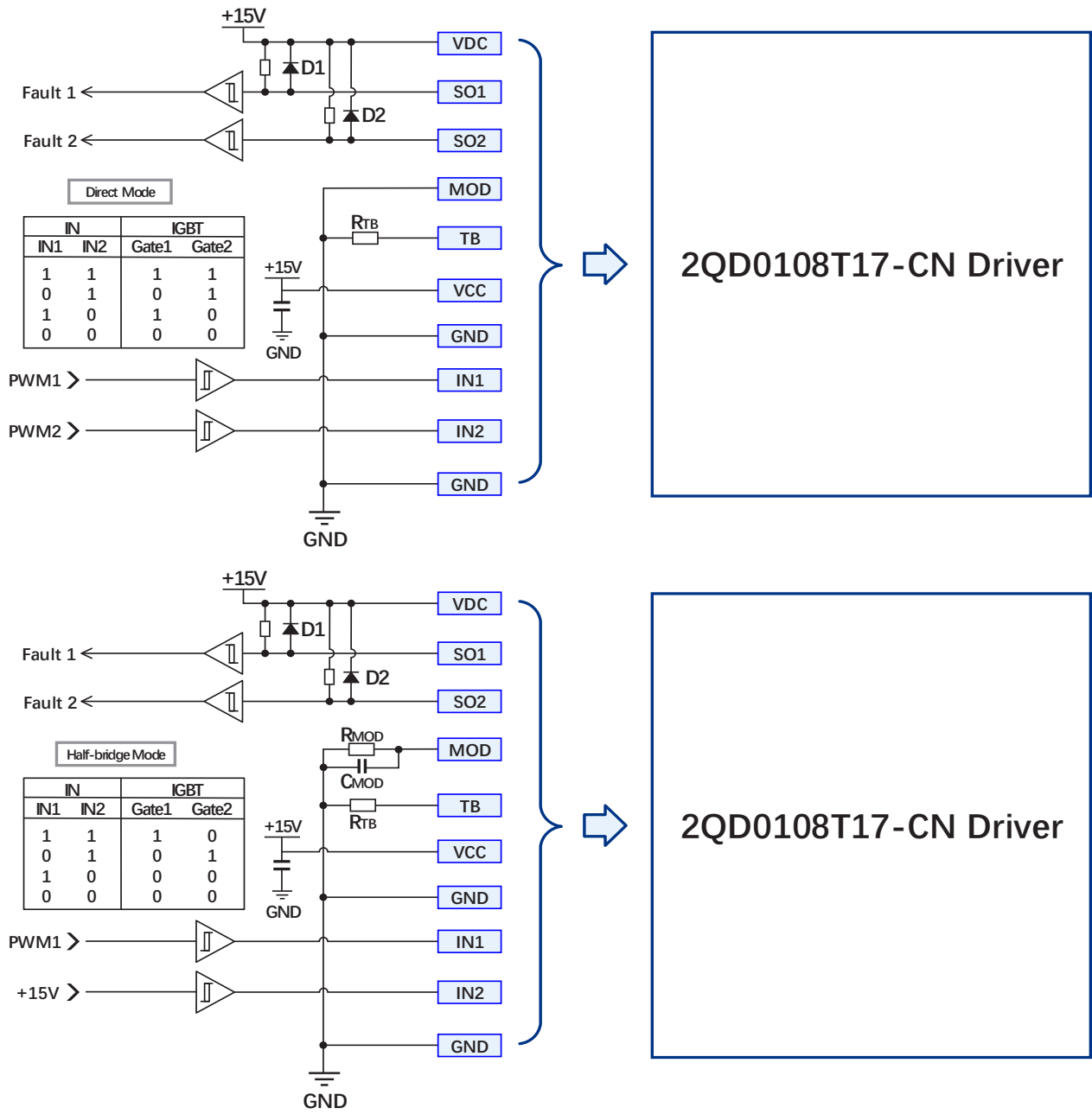


原理框图

2QD0108T17-CN Driver



典型接线图



接口定义

P2 端子接口定义

管脚	符号	说明	管脚	符号	说明
1	GND	信号 / 功率地	5	TB	保护闭锁时间设置
2	IN1	1 通道触发信号输入	6	SO2	2 通道故障信号输出
3	IN2	2 通道触发信号输入	7	SO1	1 通道故障信号输出
4	VCC	供电电源输入 +15V	8	MOD	模式选择

P1 端子接口定义

管脚	符号	说明
1	GH2	2 通道门极开通输出端 ¹⁾
2	VE2	2 通道驱动电源参考电位端 ²⁾
3	GL2	2 通道门极关断输出端 ³⁾
4	REF2	2 通道 VCE 保护门槛电压设置端 ⁴⁾
5	VCE2	2 通道 VCE 检测端 ⁵⁾

注：默认配置接口 5pin 单排针，型号：1*5pin，品牌为：百富特。

- 1) 驱动器门极开通输出端，外接门极开通电阻 R_{GON} ，开通时拉到 VISO 电位，关断时高阻态。
- 2) 驱动器参考电位；外接支撑电容和 IGBT 模块发射极。
- 3) 驱动器门极关断输出端，外接门极关断电阻 R_{GOF} ，关断时拉到 COM 电位，开通时高阻态。
- 4) 驱动器退饱和和检测内部比较器门槛电压设置引脚，详见“IGBT 短路保护”。
- 5) 驱动器退饱和和检测引脚，详见“IGBT 短路保护”。

P3 端子接口定义

管脚	符号	说明
1	GH1	1 通道门极开通输出端 ¹⁾
2	VE1	1 通道驱动电源参考电位端 ²⁾
3	GL1	1 通道门极关断输出端 ³⁾
4	REF1	1 通道 VCE 保护门槛电压设置端 ⁴⁾
5	VCE1	1 通道 VCE 检测端 ⁵⁾

注：默认配置接口 5pin 单排针，型号：1*5pin，品牌为：百富特。

- 1) 驱动器门极开通输出端，外接门极开通电阻 R_{GON} ，开通时拉到 VISO 电位，关断时高阻态。
- 2) 驱动器参考电位；外接支撑电容和 IGBT 模块发射极。
- 3) 驱动器门极关断输出端，外接门极关断电阻 R_{GOF} ，关断时拉到 COM 电位，开通时高阻态。
- 4) 驱动器退饱和和检测内部比较器门槛电压设置引脚，详见“IGBT 短路保护”。
- 5) 驱动器退饱和和检测引脚，详见“IGBT 短路保护”。

参数

绝对限值

参数	MIN	MAX	UNIT
VCC to GND	14.5	15.5	V
IN1, IN2, SO1, SO2 to GND	0	VCC	V
门极驱动功率 ¹⁾		1	W
门极驱动电流		8	A
母线电压 ²⁾		1200	V
供电电源最大电流 ³⁾		360	mA
最大开关频率		50	kHz
运行温度 T _A	-40	85	°C
存储温度 T _S	-40	85	°C
注：1) 在 T _A 允许温度范围内，单通道最大输出功率。 2) 默认有源钳位参数下允许的最大母线电压。 3) 驱动板额定工况的最大值。			

供电电源

环境温度 T_A=25°C，配合 2AB0108T17-C 底板进行测试，除非另有说明。

参数	测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
供电电压 V _{CC}	VCC to GND		15		V
供电电流	V _{CC} =15V，静态电流		45		mA
	V _{CC} =15V，100nF 负载，f _{SW} =3kHz，50% 占空比		80		mA
副边全压 V _{CCO} ¹⁾	VISO to COM		24.5		V
副边正压 V ₊	VISO to VE		15		V
副边负压 V ₋ ²⁾	COM to VE		-9.5		V
注：1) 副边全压典型值为空载测试值。 2) 副边负压典型值为空载测试值。					

输入

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，配合 2AB0108T17-C 底板进行测试，除非另有说明。

参数		测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
IN1, IN2 输入电压 $V_{IN}^{1)}$	电压限值	$V_{CC}=15\text{V}$	7			V
	开通门槛 V_{INH}	$V_{CC}=15\text{V}$		3.3		V
	关断门槛 V_{INL}	$V_{CC}=15\text{V}$		2.3		V
MOD 模式选择 $^{2)}$	直接模式	$V_{CC}=15\text{V}$, MOD 端接地		0		k Ω
	半桥模式	$V_{CC}=15\text{V}$, MOD 端通过电阻接地	72	150	182	k Ω
t_B 保护延时电阻 $^{3)}$	外部电阻 R_{TB}	$V_{CC}=15\text{V}$	75		150	k Ω
注：1) 输入端需考虑电阻分压，详见功能描述“触发信号 INx 输入”。 2) 驱动器模式选择及死区时间配置电阻，详见功能描述“传输逻辑和模式选择”。 3) 驱动器保护锁定时间配置电阻，详见功能描述“保护锁定时间 t_B 的设置”。						

输出

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，配合 2AB0108T17-C 底板进行测试，除非另有说明。

参数		测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
门极输出电压 V_G	开通 ON-State	$V_{CC}=15\text{V}$, 空载		15		V
	关断 OFF-State	$V_{CC}=15\text{V}$, 空载		-9.5		V
门极电流 I_G	开通 ON-State	$V_{CC}=15\text{V}$, $R_{GON}=0.5\Omega$			8	A
	关断 OFF-State	$V_{CC}=15\text{V}$, $R_{GOFF}=0.5\Omega$	-8			A
SO 输出电压 $V_{SO}^{1)}$	正常状态	$V_{CC}=15\text{V}$, $R_{SO}=33\Omega$		15		V
	保护状态	$V_{CC}=15\text{V}$, $R_{SO}=33\Omega$		0.7		V
注：1) R_{SO} 为保护输出端 SO 限流电阻，位于驱动内部， R_{PULL} 为上拉电阻，位于底座板上，默认为 15V 上拉，可根据客户需求调整。						

保护

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，配合 2AB0108T17-C 底板进行测试，除非另有说明。

参数	测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
短路保护阈值电压 V_{REF}	$V_{CC}=15\text{V}$		10.2		V
短路保护响应时间 $t_{SC}^{1)}$	$U_{BUS}>500\text{V}$, $R_A=62\text{k}\Omega$, $C_A=33\text{pF}$		9.0		us
保护锁定时间 t_B	$R_{TB}=150\text{k}\Omega$		99		ms
短路保护传输延时时间 $t_{SO}^{2)}$	$V_{CC}=15\text{V}$, 副边短路保护动作到输出故障		450		ns
注：1) 采用串电阻检测方式。 2) 副边保护动作开始（8Pin 信号电平拉低）到原边 SO 翻转的传输延迟时间。					

时序

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，配合 2AB0108T17-C 底板进行测试，除非另有说明。

参数		测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
传输延时 ¹⁾	开通延时 t _{ON}	V _{CC} =15V, R _{MOD} =0Ω, R _{GON} =0.5Ω, R _{G_{OFF}} =0.5Ω, C _{GE} =100nF, f _s =3kHz	300			ns
	关断延时 t _{OFF}		300			ns
输出信号上升时间 t _r		R _{GON} =0.5Ω, C _{GE} =100nF	1300			ns
输出信号下降时间 t _f		R _{G_{OFF}} =0.5Ω, C _{GE} =100nF	1400			ns
死区时间 DT ²⁾		半桥模式, MOD 端通过 150kΩ 电阻接地	2.6			us
注： 1) 开通传输延时为输入信号上升沿 10% 到门极信号上升沿 10%，关断传输延时为下降输入信号沿 10% 到门极信号下降沿 10%。 2) 客户端可使用直接模式，并在控制端进行死区时间设置。						

安全和抗干扰

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，配合 2AB0108T17-C 底板进行测试，除非另有说明。

参数		数值	UNIT
绝缘耐压 ¹⁾		6000	V
原边 - 副边 ²⁾	隔离等效电容	10	pF
	电气间隙	13.2	mm
	爬电距离	13.2	mm
副边 - 副边	隔离等效电容	8.5	pF
	电气间隙	3.4	mm
	爬电距离	5.3	mm
ESD 静电防护	接触放电	4	kV
	空气放电	8	kV
电快速瞬变脉冲群抗扰度 ³⁾		0.5	kV
注：1) 测试条件为 6000V, 15kHz 交流电压, 1min。 2) 电气间隙和爬电距离，按照 IEC 60077-1 标准设计。 3) EMC 测试安装 GB/T 17626 规范执行。			

特性和曲线

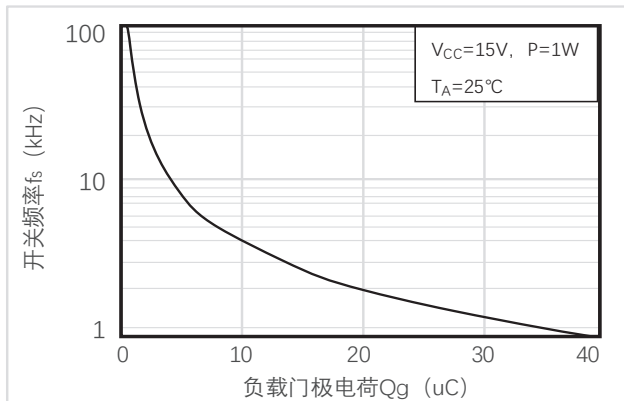


图1 负载门极电荷vs开关频率

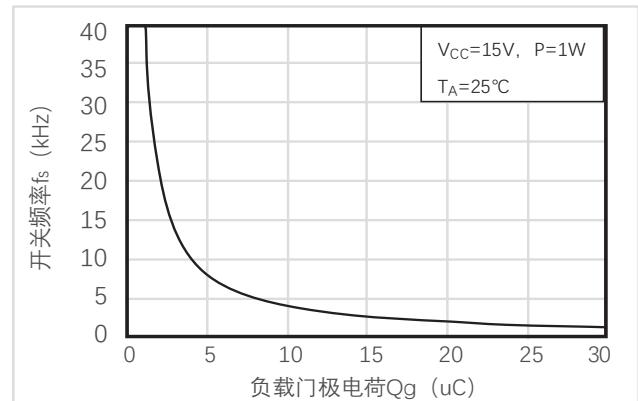


图2 负载门极电荷vs开关频率

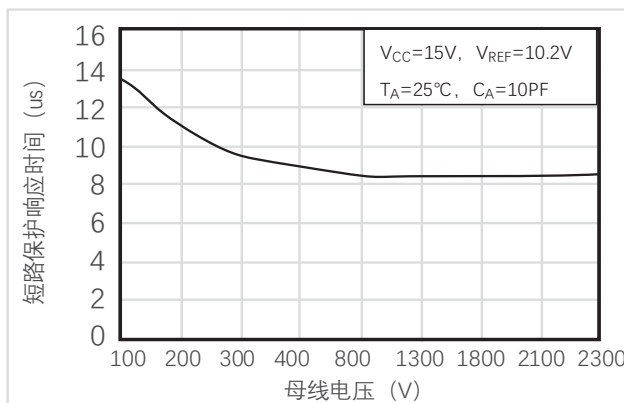


图3 短路保护响应时间vs母线电压

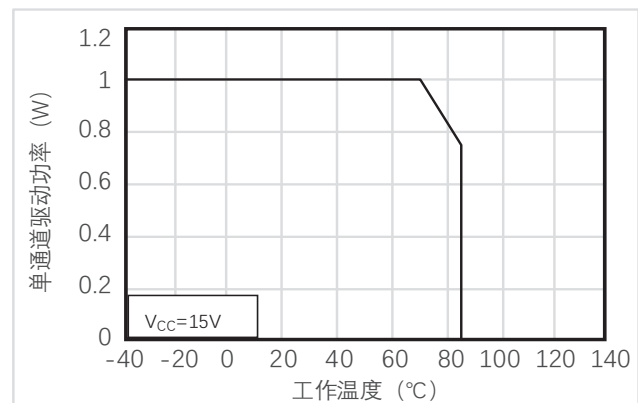


图4 驱动功率vs工作温度

功能描述

电源及电源监控

这款驱动器配有隔离 DC/DC 电源，可实现电源和门极驱动电路的电气隔离，基本原理框图（如图 5 所示）。

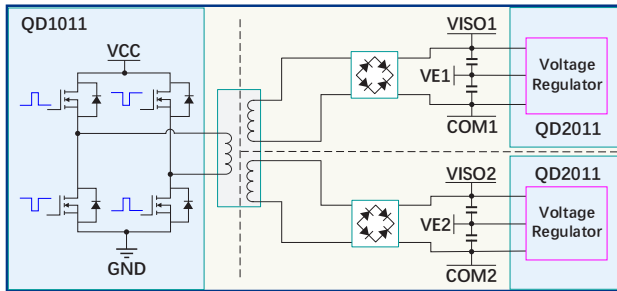


图 5 电源原理框图

驱动器的原边及两个通道的副边都分别配备有电源监控电路，并实施欠压保护。

注意，驱动器需要稳定的供电电压！

原边电源监控

原边对电源电压 V_{CC} 进行监控并实施欠压保护动作。当 V_{CC} 逐渐降低至欠压保护触发电压 V_{CCUV} 时，将触发欠压保护。两个副边驱动电路将锁定在关断状态，使 IGBT 保持在关断；同时输出保护信号 $SO1$ 和 $SO2$ （如图 6 所示）。

当 V_{CC} 恢复到欠压恢复值 V_{CCUVR} ，驱动器将继续保持保护状态一个锁定时间 t_B ，再释放驱动电路关断锁定状态，并恢复保护信号 $SO1$ 和 $SO2$ 。

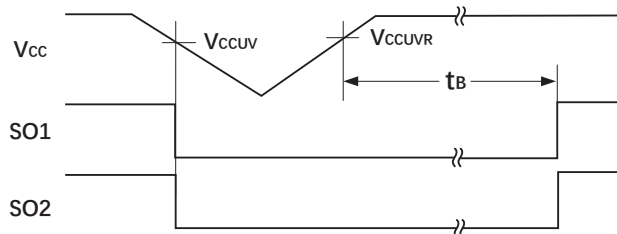


图 6 原边欠压保护逻辑图

副边电源监控

副边电压在供电电压降低或负载超载情况下，会发生电压下降。当副边电压全压 V_{CCO} （VISO 至 COM 下同）下降时，驱动器会优先稳住正压 $V+$ （VISO 至 VE 下同）为 +15V，负压 $V-$ （COM 至 VE 下同）逐渐抬升。当 $V-$ 抬升到 -5V 后，开始稳住负压，正压 $V+$ 开始跟随全压 V_{CCO} （VISO 至 COM，下同）下降。当 $V+$ 下降至欠压保护阈值 V_{UV+} ，将启动副边欠压保护。

副边欠压保护首先会将本通道驱动锁定在关断状态，确保对应 IGBT 关断。同时向原边发送信号，使得原边输出对应通道的保护信号 SOx 。此时，另一通道不会受影响，仍能正常开关，其对应的 SO 信号为正常状态。

当故障情况解除， V_{CCO} 恢复后，驱动器会先恢复正压，再恢复负压。保护闭锁状态和 SO 信号将会等待一个闭锁时间 t_B ，再恢复正常。

副边电压调节和欠压保护逻辑（参见图 7）。

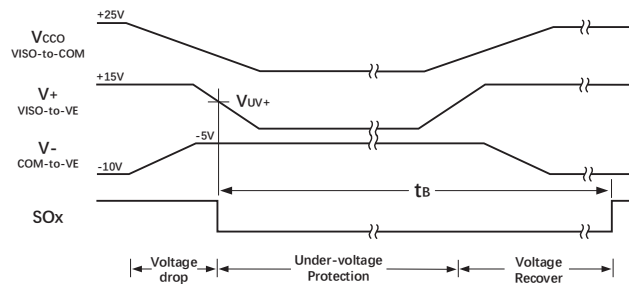


图 7 副边欠压保护逻辑图

触发信号 INx 输入和传输逻辑

触发信号由 INx 端口输入（参见图 8），默认状态 $R12/R13=390\Omega$ ， $R5/R6=N.C.$ 。

需要改变输入信号电平时，可通过焊接 $R5/R6$ 电阻来改变输入信号开通阈值 V_{INH} 、关断阈值 V_{INL} 。

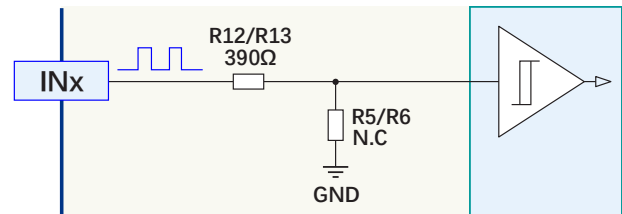


图 8 INx 输入电路图

传输逻辑和模式选择

驱动器可工作在直接模式或者半桥模式。可通过调整 MOD 端子的不同连接方式，选择驱动器的工作模式。

直接模式

如果 MOD 端处于低电平（接地），则选择了直接模式，传输逻辑（参见图 9）。直接模式时，两个通道各自独立，没有联系。输入 $IN1$ 对应 1 通道，而输入 $IN2$ 对应 2 通道。高电平将对应的 IGBT 开通，低电平将对应的 IGBT 关断。

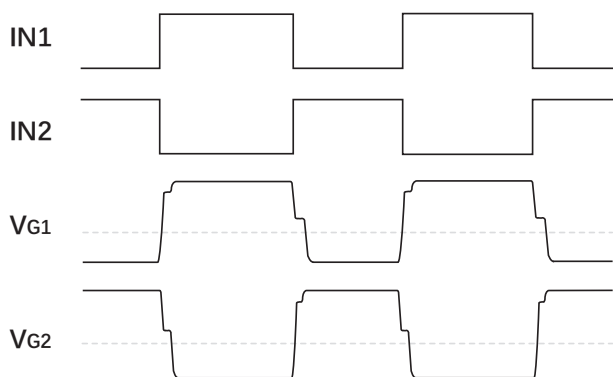


图9 直接模式传输逻辑图

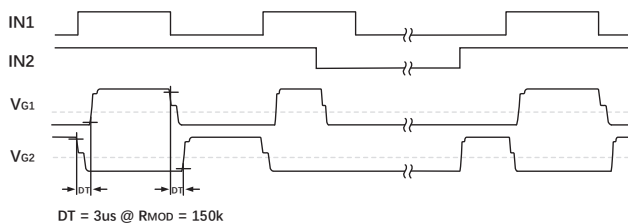
注意：此时，触发信号间的死区时间由前端控制系统产生，请确保死区时间合适以避免发生上下管直通短路。

半桥模式

如果MOD接口通过一个电阻接地，驱动器就选择了半桥模式，传输逻辑（参见图10）。在这种模式下，IN1为驱动信号输入，而IN2为使能信号。

当IN2为低电平时，两个通道都锁定在关断状态；如果IN2为高电平，则两个通道都被使能，且两个通道的门极输出由IN1来决定。当IN1信号由低变高，2通道的门极信号会马上关断，经过一个死区时间DT后，1通道的门极会开通；但IN1信号由高变低时，则是1通道门极信号马上关断，经过死区时间DT后2通道再开通。

死区时间DT为3us。



DT = 3us @ RMOD = 150k

图10 半桥模式传输逻辑图

保护锁定时间的设置

驱动器出现保护的时候，在启动保护并输出SO信号后都会闭锁一个 t_B 保护锁定时间。此 t_B 可通过在TB管脚和GND之间接一个外加电阻 R_{TB} 进行设置（参见图11）。

需要注意的是2QD0108T17-CN驱动器在TB端要外接一个 R_{TB} 的电阻到地。 t_B 和 R_B 的关系由以下公式给出（典型值）：

$$t_B[\text{ms}] = 1 \cdot R_{TB}[\text{k}\Omega] - 51$$

$$(71\text{k}\Omega \leq R_{TB} \leq 181\text{k}\Omega, 20\text{ms} \leq t_B \leq 130\text{ms})$$

当 R_{TB} 为150k Ω 时，保护锁定时间 t_B 约为99ms。TB管脚不可以悬空。

注意 R_{TB} 电阻不能小于71k Ω ，即保护锁定时间 t_B 不能小于20ms。如 R_{TB} 小于71k Ω ，保护锁定时间 t_B 将出现不准确和不稳定。但TB管脚可以接地，此时保护锁定时间 t_B 固定为10us。

推荐将TB管脚接150k Ω ，此时保护锁定时间 t_B 约为99ms。

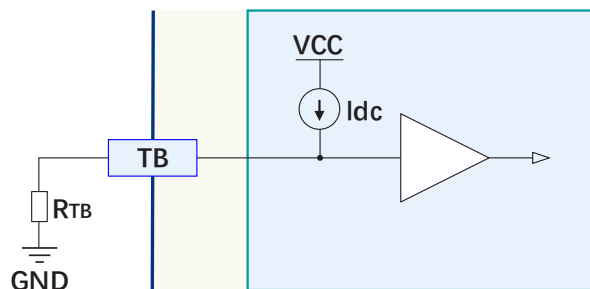


图11 TB管脚连接图

IGBT的开通和关断

QON管打开，QOFF管关闭，通过开通门极电阻 R_{GON} 对IGBT的门极进行充电，使IGBT开通。驱动器在内置芯片外部还扩展了一个开通MOSFET，以拓展开通驱动电流到8A。

当需要关断IGBT时，驱动器内部芯片内的QOFF管打开，QON管关闭，通过关断门极电阻 R_{GOFF} 对IGBT的门极进行放电，使IGBT关断。

门极电阻 R_{GON} 和 R_{GOFF} 的选择，用户可咨询我们技术支持来进行设置，并进行出厂预配置。在安装到对应的IGBT模块上时，请确保已经安装上合适的门极电阻。

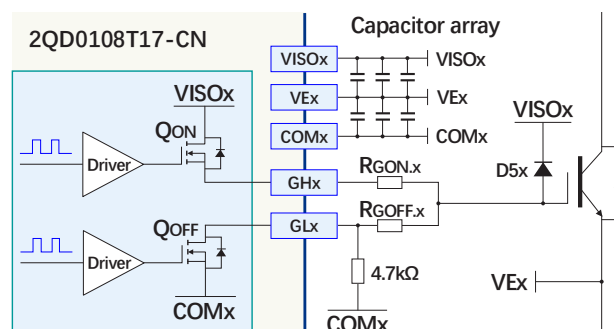


图12 门极驱动电路图

有源钳位

快速的关断 IGBT 可能导致电压尖峰，电压尖峰会随母线电压和负载电流升高而增加，过高的电压尖峰会对 IGBT 的安全造成威胁。关断电压尖峰主要与系统杂散电抗 L_s 和 IGBT 关断电流变化率 di/dt 有关，通过调整关断门极电阻 $R_{G\text{OFF}}$ 可适当减少 di/dt ，从而适当减少尖峰电压；但 L_s 的影响不可避免，特别是在短路和过流等大电流工况下，情况尤其恶劣。故此，驱动器配备了有源钳位电路，以抑制过电压尖峰，可以有效的防止 IGBT 的过压损坏。

有源钳位电路的原理（参见图 13）。在 IGBT 的集电极和门极之间用瞬态抑制二极管（TVS）建立一个反馈通道，同时连接内部芯片的控制电路。

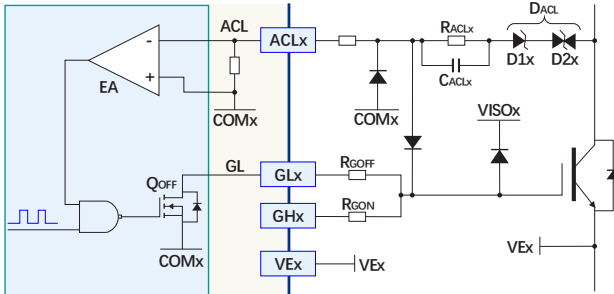


图 13 有源钳位电路原理图

当 IGBT 的 V_{CE} 尖峰电压超过一个击穿阈值时，TVS 串将打通，芯片内部控制电路启动使得关断驱动管 Q_{OFF} 关断；同时 TVS 串流过的电流将会注入 IGBT 门极，使得 IGBT 仍保持部分导通，从而令 IGBT 的 V_{CE} 得到抑制。

驱动器的预设击穿阈值如表 1 所示。

表 1 有源钳位阈值表 ($T_A=25^\circ\text{C}$)

驱动型号	模块电压等级	击穿阈值
2QD0108T17-CN	1700V	1320V

IGBT 短路保护

驱动器的 IGBT 短路保护使用 V_{CE} 检测电路（参见图 14），两个通道各自独立。短路保护功能只在 IGBT 开通的时候有效；在 IGBT 关断状态，触发信号会将 Q_{CE} 打开，使得 V_{CEDT} 钳位在 $COMx$ （相对 VEx 为 $-10V$ 左右），比较器不动作。

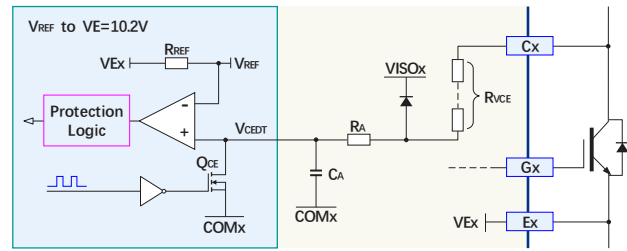


图 14 短路保护检测原理框图

正常开通时的表现

当驱动器执行 IGBT 开通动作时，传输到副边的触发信号会将 Q_{CE} 关断，释放 V_{CEDT} 钳位状态。此时 IGBT 的 V_{CE} 仍处于高水平，将通过 R_{VCE} 电阻串和 R_A 电阻对 C_A 电容进行充电，使得 V_{CEDT} 电平逐渐抬升。随后 IGBT 开通， V_{CE} 迅速下降至 V_{CE-SAT} ， V_{CEDT} 也随之充电至 V_{CE-SAT} （参见图 15）。由于 V_{CE-SAT} 远低于保护触发值 V_{REF} ，比较器不动作，保护不启动。

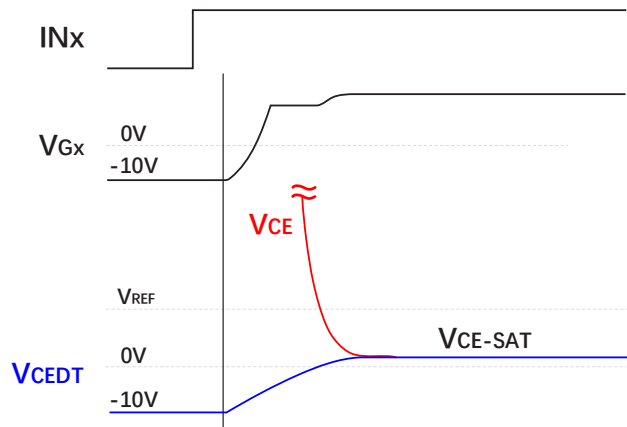


图 15 正常开通时 V_{CEDT} 信号波形图

一类短路保护

当 IGBT 发生一类短路（即直通）时，由于直通电流增长很快，IGBT 将迅速退饱和， V_{CE} 很快回到高位。因此 C_A 将会一直充电，使得 V_{CEDT} 一直增长直到钳位至 $VISOx$ （相对 VEx 为 $+15V$ ）。在此过程中， V_{CEDT} 会越过 V_{REF} ($10.2V$)，使得比较器翻转，从而启动短路保护逻辑。

短路保护逻辑会先把 IGBT 迅速关断，保障 IGBT 的安全。同时向原边发出信息，使得 SOx 管脚拉低，以表达出保护状态。保护状态将会锁定一个 t_b 时间，然后自动恢复到正常状态。

两个通道的保护电路是相互独立的，所以在在一个通道发生短路保护的情况下，另一通道仍然能够工作在正常状态。控制系统需要及时检测 SO 信号，并根据策略发出系统闭锁命令（参见图 16）。

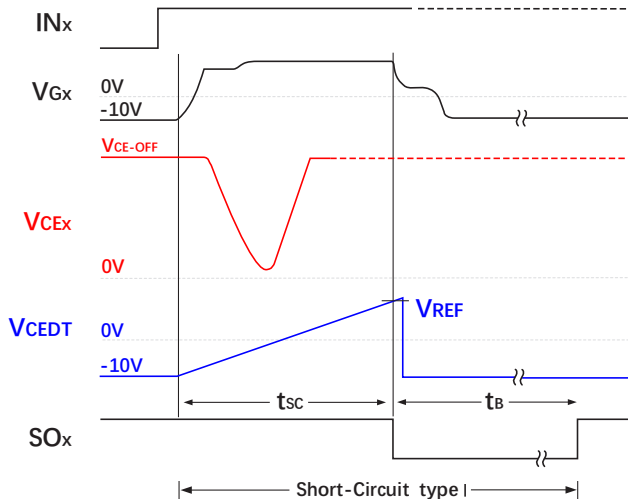


图 16 一类短路保护逻辑图

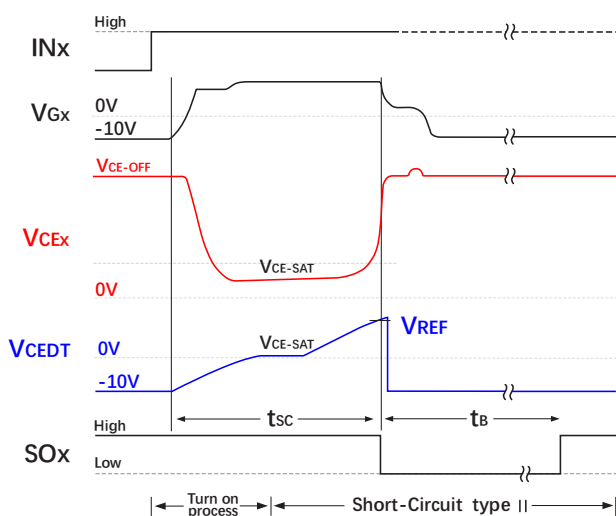


图 17 二类短路保护逻辑图

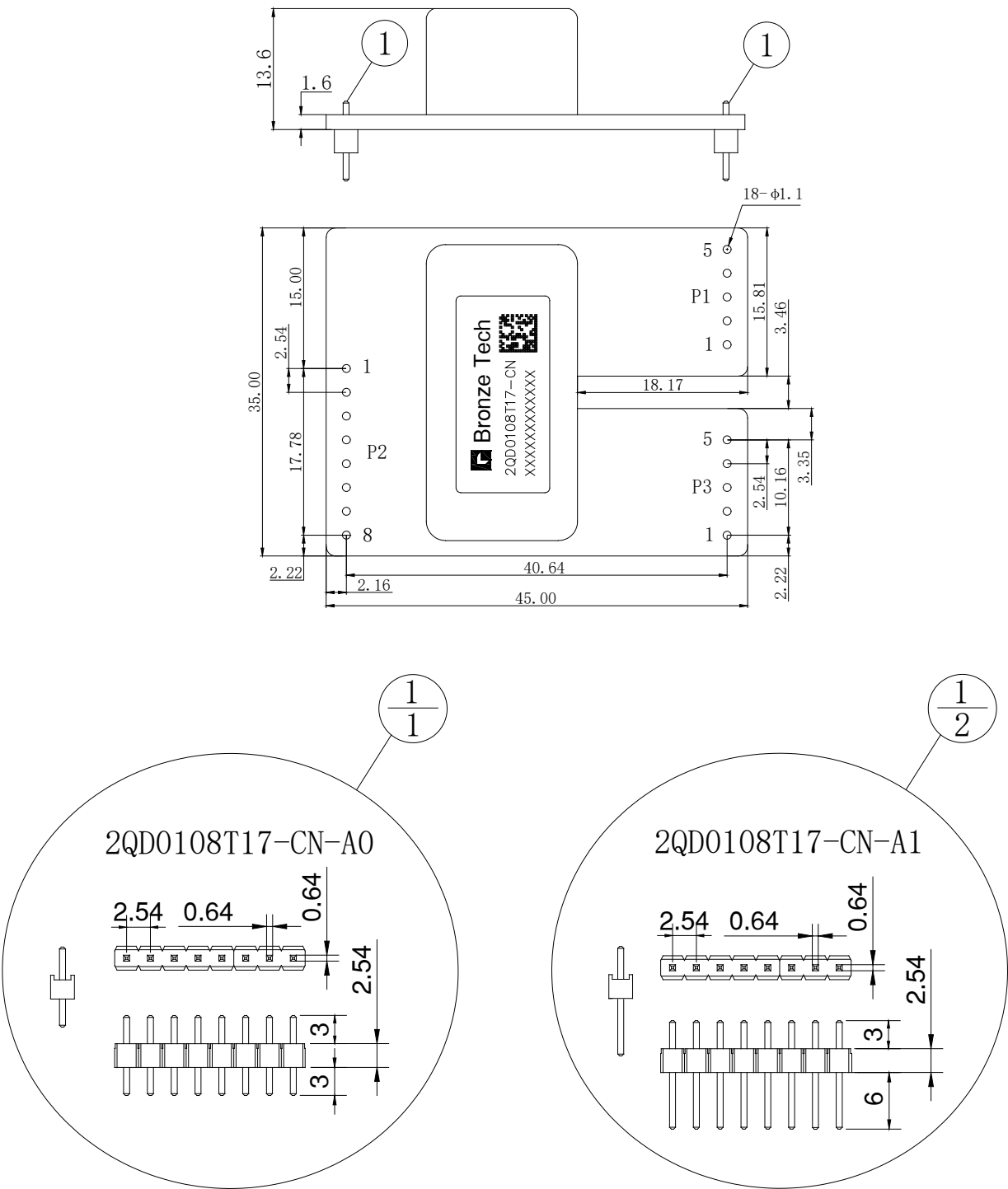
二类短路保护

当 IGBT 发生二类短路（相间短路）时，由于短路回路阻抗较大，电流增长较缓慢。IGBT 仍能正常进入饱和状态，然后随着短路电流的增加， V_{CE} 逐渐增加直至退饱和（参见图 17）。驱动器只有在 IGBT 退饱和时才能检测出短路状态，启动短路保护。因此，二类短路保护的响应时间会比一类短路保护响应时间要更长。

当 IGBT 在低母线电压下发生直通短路时，由于母线电压低导致直通电流较小，IGBT 也会呈现与二类短路保护相同的特征，相应的保护响应时间也会加长。

注意：二类短路时，由于短路回路阻抗随机性较大，使得 IGBT 退饱和时刻不确定性较大。因此在 IGBT 保护动作前，有可能已产生较大的热量损耗而导致 IGBT 损坏。即，此种状态下驱动器短路保护并不能保证 IGBT 不损坏，系统需辅以过流保护等其他手段，以保障 IGBT 的安全。

机械结构图



注: 1) 图示单位为 mm;

2) 图中公差符合 ISO 2768-1。

原边及副边的管脚间距是 2.54mm (100mil)，管脚的横截面尺寸为 0.64mm x 0.64mm，推荐焊孔直径 ϕ 1.0mm。产品外形尺寸 45mm x 35mm，从管脚到底端到产品最高顶端的高度有两种配置：

2QD0108T17-CN-A0：高度为 16.14mm，针脚长度（裸露部分）3mm。

2QD0108T17-CN-A1：高度为 16.14mm，针脚长度（裸露部分）6mm。

版本说明

版本号	变更内容	修订日期
V1.0	新发布	22-Jul-2021
V1.1	型号定义增加 A0、A1，典型接线图变更，机械结构图增加两种排针尺寸	05-Aug-2021
V1.2	部分数值优化	21-Apr-2022

注意事项

- IGBT 模块和驱动器的任何操作，均需符合静电敏感设备保护的通用要求，请参考国际标准 IEC 60747-1/IX 或欧洲标准 EN100015。为保护静电感应设备，要按照规范处理 IGBT 模块和驱动器（工作场所、工具等都必须符合这些标准）。



如果忽略了静电保护要求，IGBT 和驱动器可能都会损坏！

- 驱动器上电前，请确认驱动器和控制板连接可靠，无空接、虚接、虚焊现象。
- 驱动器安装后，其表面对大地电压可能会超过安全电压，请勿徒手接触！



使用中，可能危及生命，务必遵守相关的安全规程！

免责声明

青铜剑技术提供的技术和可靠性数据（包括数据手册等）、设计资源（包括 3D 模型、结构图、AD 模型）、应用指南、应用程序或其他设计建议、工具、安全信息和资源等，不包含所有明示和暗示的保证，包括对交付、功能、特定用途、适用性保证和不侵犯第三方知识产权的保证。

这些资源旨在为使用青铜剑技术产品进行开发的熟练工程师提供。为您全权负责：

- (1) 为您的产品选择适当的青铜剑技术产品；
- (2) 设计、验证和测试您的产品；
- (3) 确保您的产品符合适用的要求。

青铜剑技术保留随时修改数据、文本和资料的权力，恕不另行通知。请随时访问青铜剑技术网站 www.qjtjtec.com 或微信公众号，以获取最新的资料。

青铜剑技术授权您仅在应用青铜剑技术产品的开发过程，使用相应的资源；禁止以其他方式复制和展示这些资源。青铜剑技术没有通过这些资源，授予任何青铜剑技术的知识产权或第三方知识产权许可。

对于因您使用这些资源而引起的任何索赔、损害、损失和成本，青铜剑科技不承担任何责任，并且有权追偿因侵犯知识产权而造成的损失。

